

**Lenovo**

# ThinkSystem SR630 V4 내장 케이블 배선 가이드



시스템 유형: , 7DK1 7DG8, 7DG9, 7DGA, 7DGB

## 주의

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에 다음에서 제공되는 안전 정보 및 안전 지시사항을 읽고 이해하십시오.

[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)

또한 다음에서 제공되는 서버에 대한 Lenovo 보증 계약조건에 대해서도 숙지해야 합니다.

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

초판 (2024년 11월)

© Copyright Lenovo 2024.

권리 제한 및 제약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제약 사항이 적용됩니다.

---

# 목차

목차 . . . . .	i	직렬 포트 모듈 . . . . .	13
안전 . . . . .	iii	백플레인의 케이블 배선 . . . . .	14
안전 점검 목록 . . . . .	iv	4 x 2.5" 앞면 드라이브 . . . . .	14
내장 케이블 배선 . . . . .	1	8 x 2.5" 앞면 드라이브 . . . . .	19
커넥터 식별 . . . . .	1	10 x 2.5" 앞면 드라이브 . . . . .	24
드라이브 백플레인 커넥터 . . . . .	1	부록 A. 문서 및 지원 . . . . .	29
앞면 I/O 모듈 . . . . .	3	문서 다운로드 . . . . .	29
앞면 어댑터 어셈블리 . . . . .	4	지원 웹 사이트 . . . . .	29
내부 M.2 드라이브 백플레인 . . . . .	5	부록 B. 주의사항 . . . . .	31
침입 스위치 . . . . .	6	상표 . . . . .	31
OCP 인터포저 카드 . . . . .	7	중요 참고사항 . . . . .	32
OCP 모듈 . . . . .	8	전자 방출 주의사항 . . . . .	32
Processor Neptune™ Air Module . . . . .	9	대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언 . . . . .	33
Processor Neptune™ Core Module . . . . .	10	대만 지역 수입 및 수출 연락처 정보 . . . . .	33
뒷면 케이블 장착 라이저 카드 . . . . .	11	TCO 인증 . . . . .	33
뒷면 M.2 드라이브 백플레인 . . . . .	12		



---

## 안전

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本產品之前，請仔細閱讀 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། རྫོང་གི་ཡིད་གཟབ་  
བྱ་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen  
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

## 안전 점검 목록

이 절의 정보를 사용하여 서버에서 잠재적으로 안전하지 않은 상태를 식별하십시오. 각 시스템이 설계되고 제작될 때 사용자와 서비스 기술자를 부상으로부터 보호하기 위해 필요한 안전 부품이 설치되었습니다.

참고: 이 제품은 작업장 규정 §2에 따라 비주얼 디스플레이 작업장에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

참고: 서버 설정은 서버실에서만 가능합니다.

경고:

이 장비는 오디오/비디오, 정보 기술 및 통신 기술 분야의 전자 장비 안전 표준인 IEC 62368-1에 정의된 대로 숙련된 인력을 통해 설치되거나 지원을 받아야 합니다. Lenovo는 사용자가 장비를 수리할 자격이 있으며 에너지 수준이 위험한 제품의 위험을 인식할 수 있는 훈련을 받은 것으로 가정합니다. 도구 또는 잠금 장치와 키 또는 다른 보안 수단을 사용하여 장비에 접근할 수 있으며, 이는 해당 위치에 대해 책임 있는 기관에 의해 통제됩니다.

중요: 서버의 전기 접지는 운영자의 안전과 정확한 시스템 기능을 위한 필수 사항입니다. 공인 전기 기술자에게 콘센트의 접지가 적절한지 확인하십시오.

잠재적으로 안전하지 않은 조건이 없는지 확인하려면 다음 점검 목록을 사용하십시오.

1. 작업 조건에 따라 서버의 전원을 꺼야 하는 경우 또는 전원을 끄려는 경우에는 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

참고: 특정 상황에서는 서버 전원을 반드시 끄지 않아도 됩니다. 작업을 수행하기 전에 주의사항을 참조하십시오.

2. 전원 코드를 확인하십시오.

- 제3선 접지 커넥터의 상태가 양호한지 확인하십시오. 측정기를 사용하여 외부 접지 핀과 프레임 접지 사이에서 제3선 접지 연속성이  $0.1\Omega$  이하인지 확인하십시오.

- 전원 코드 유형이 올바른지 확인하십시오.

서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.

- a. 다음으로 이동하십시오.

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)를 클릭하십시오.

- c. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.

- d. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전원) → Power Cables(케이블)를 클릭하십시오.

- 절연체가 헤어지거나 닳지 않았는지 확인하십시오.

3. 확연히 눈에 띄는 Lenovo 이외 개조부가 있는지 확인하십시오. Lenovo 이외 개조부의 안전을 현명하게 판단하십시오.

4. 쇠가루, 오염 물질, 수분 등의 액체류 또는 화재나 연기 피해의 흔적 등 확연하게 안전하지 않은 조건을 찾아 서버 내부를 점검하십시오.

5. 닳거나 헤어지거나 혹은 집혀서 패이거나 꺾인 케이블이 있는지 확인하십시오.

6. 전원 공급 장치 덮개 잠금 장치(나사 또는 리벳)가 제거되지 않았거나 함부로 변경되지 않았는지 확인하십시오.





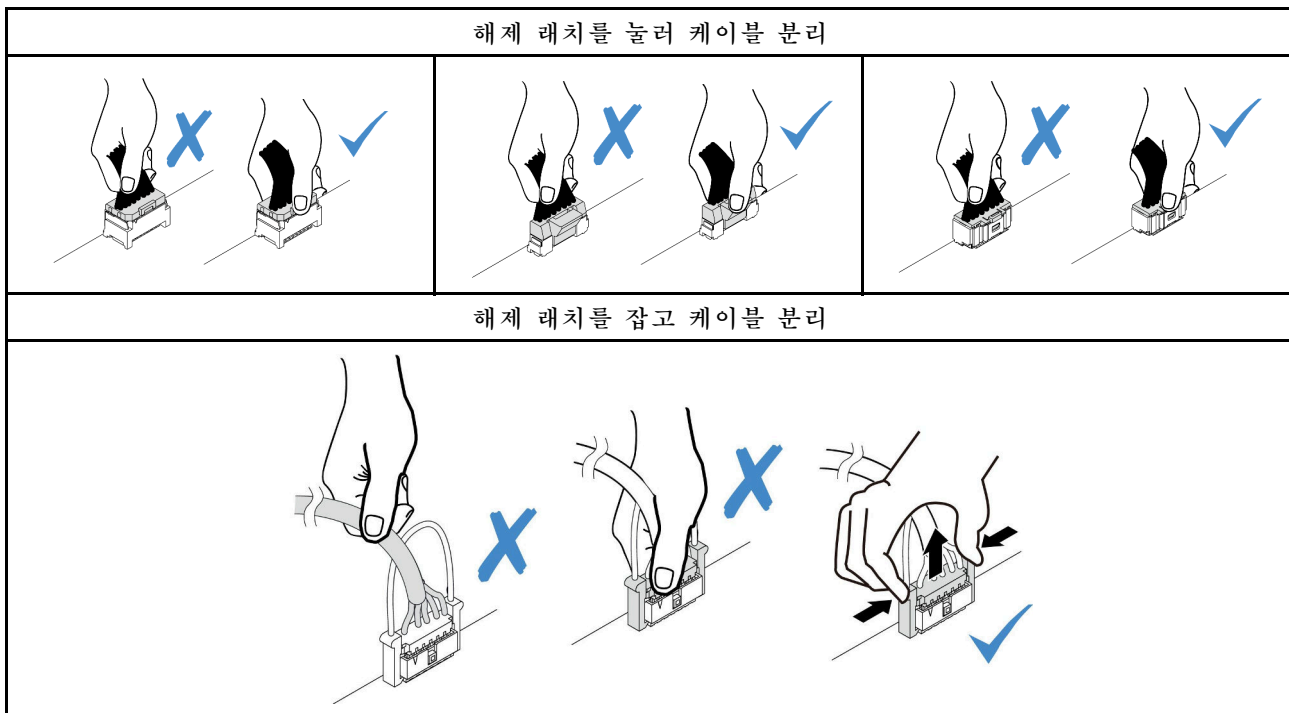
## 내장 케이블 배선

이 섹션을 참조하여 특정 구성 요소에 대한 케이블 라우팅을 수행하십시오.

참고: 아래 지침에 따라 케이블을 연결하십시오.

- 내장 케이블을 연결하거나 분리하기 전에 서버를 끄십시오.
- 추가 케이블링 지시사항은 외장 장치와 함께 제공되는 문서를 참고하십시오. 장치를 서버에 연결하기 전에 케이블을 배선하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
- 일부 케이블의 케이블 ID는 서버 및 옵션 장치와 함께 제공된 케이블에 인쇄되어 있습니다. 이 ID를 사용하여 올바른 커넥터에 케이블을 연결할 수 있습니다.
- 케이블이 고정되지 않고 시스템 보드 어셈블리의 구성 요소를 가리거나 커넥터를 덮지 않는지 확인하십시오.
- 해당 케이블이 케이블 클립을 통과하는지 확인하십시오.

참고: 시스템 보드 어셈블리에서 케이블을 분리할 때 래치, 잠금 해제 탭 또는 케이블 커넥터의 잠금 장치를 모두 분리하십시오. 케이블을 제거하기 전에 해제하지 못하면 시스템 보드 어셈블리의 케이블 포트가 손상됩니다. 케이블 포트가 손상되면 시스템 보드 어셈블리를 교체해야 할 수도 있습니다.



## 커넥터 식별

이 섹션을 참조하여 전자 보드 커넥터의 위치를 찾고 식별하십시오.

### 드라이브 백플레인 커넥터

이 섹션을 참조하여 드라이브 백플레인에서 커넥터를 찾으십시오.

- ["10 x 2.5인치 AnyBay 백플레인" 2페이지](#)

- "4 x 2.5" AnyBay 백플레인" 2페이지
- "뒷면 2 x 2.5" AnyBay 백플레인" 2페이지
- "내부 M.2 드라이브 백플레인" 3페이지
- "뒷면 M.2 드라이브 백플레인" 3페이지

### 10 x 2.5인치 AnyBay 백플레인

이 섹션을 참조하여 10 x 2.5" 드라이브 백플레인에서 커넥터를 찾으십시오.

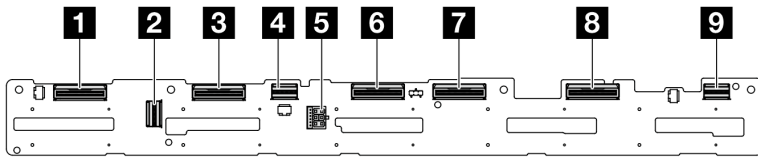


그림 1. 10 x 2.5" AnyBay 백플레인

- 1** NVMe 8-9
- 2** SAS 2
- 3** NVMe 6-7
- 4** SAS 1
- 5** 전원
- 6** NVMe 4-5
- 7** NVMe 2-3
- 8** NVMe 0-1
- 9** SAS 0

### 4 x 2.5" AnyBay 백플레인

이 섹션을 참조하여 4 x 2.5" 드라이브 백플레인에서 커넥터를 찾으십시오.

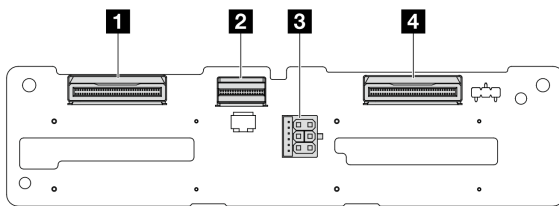


그림 2. 4 x 2.5" AnyBay 백플레인

- 1** NVMe 2-3
- 2** SAS
- 3** 전원
- 4** NVMe 0-1

### 뒷면 2 x 2.5" AnyBay 백플레인

이 섹션을 참조하여 뒷면 2 x 2.5" 드라이브 백플레인에서 커넥터를 찾으십시오.

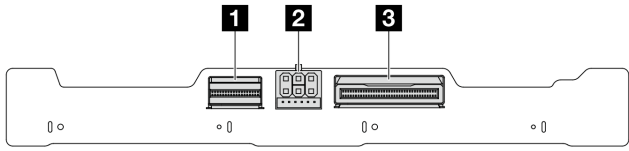


그림 3. 뒷면 2 x 2.5" AnyBay 백플레인

- 1 SAS
- 2 전원
- 3 NVMe

### 뒷면 M.2 드라이브 백플레인

이 섹션을 참조하여 뒷면 M.2 드라이브 백플레인에서 커넥터를 찾으십시오.

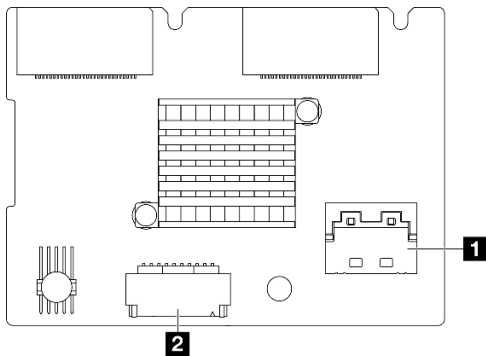


그림 4. 뒷면 M.2 드라이브 백플레인

- 1 신호
- 2 전원

### 내부 M.2 드라이브 백플레인

내부 백플레인의 M.2 커넥터 위치에 대한 자세한 내용은 *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 설명서*의 "내부 M.2 백플레인 및 M.2 드라이브 교체"를 참조하십시오.

---

## 앞면 I/O 모듈

이 섹션을 사용하여 앞면 I/O 모듈의 케이블 배선을 알아보십시오.

### 앞면 I/O 모듈의 케이블 배선

- 프로세서 보드의 앞면 I/O 모듈 커넥터 위치의 경우 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 보드 어셈블리 커넥터"에서 자세한 내용을 참조하십시오.
- 이 그림에서는 2.5" 앞면 드라이브 베이이 지원되는 서버 모델의 케이블 배선을 보여줍니다. 서버 앞면에 있는 각 커넥터 위치는 모델에 따라 다릅니다. 다른 모델의 앞면 I/O 구성 요소 위치에 대한 자세한 정보는 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "앞면" 및 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "앞면 I/O 모듈"을 참조하십시오.

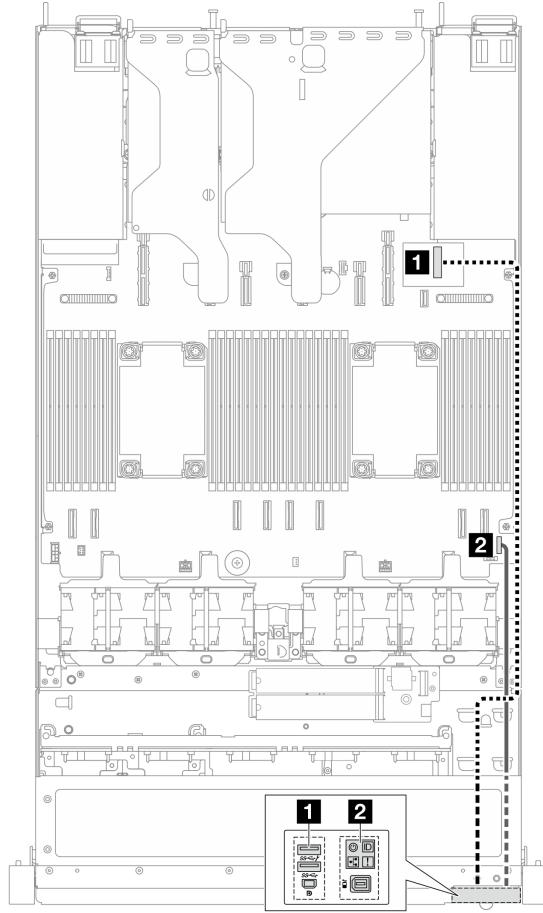


그림 5. 앞면 I/O 모듈의 케이블 배선

시작	끝
<b>1</b> USB 및 MiniDP 커넥터 <a href="#">참고</a>	<b>1</b> USB I/O 보드
<b>2</b> 앞면 오버레이터 패널	<b>2</b> FIO 커넥터

참고: USB 및 MiniDP 커넥터는 특정 앞면 I/O 모듈에서 사용할 수 없습니다.

## 앞면 어댑터 어셈블리

이 섹션에서 앞면 어댑터 어셈블리의 전원 케이블 및 신호 케이블 배선을 알아보십시오.

프로세서 보드의 앞면 어댑터 어셈블리 커넥터 위치의 경우 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 보드 어셈블리 커넥터"에서 자세한 내용을 참조하십시오.

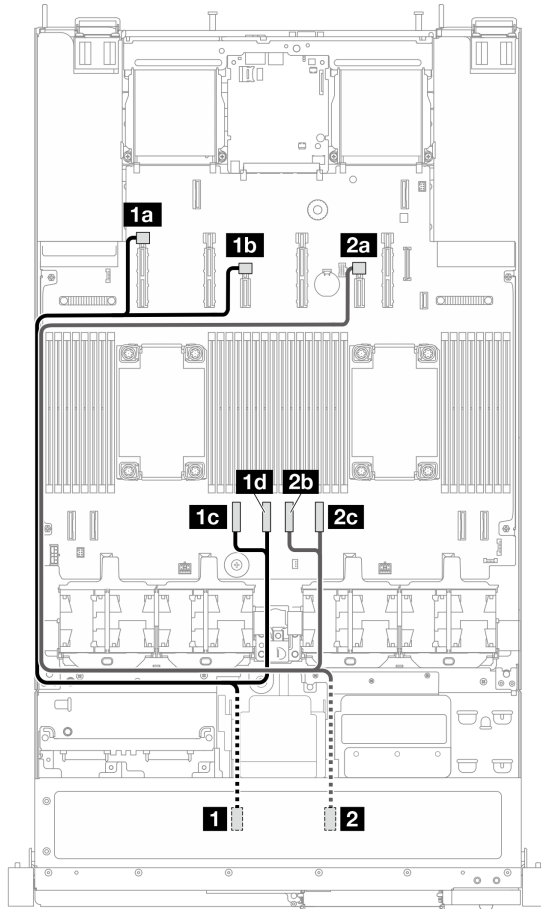


그림 6. 앞면 어댑터 어셈블리의 케이블 배선

시작	끝
1 슬롯 4의 라이저 5-4 카드	1a 전원 및 PCIe 커넥터 15의 전원참고
	1b 전원 및 PCIe 커넥터 12의 전원참고
	1c PCIe 커넥터 6
	1d PCIe 커넥터 5
2 슬롯 5의 라이저 5-4 카드	2a 전원 및 PCIe 커넥터 10의 전원
	2b PCIe 커넥터 4
	2c PCIe 커넥터 3

참고: 앞면 케이블 장착 라이저에서 나오는 전원 커넥터는 다음으로 이동합니다.

- 1a - 표준 또는 성능 방열판이 설치된 경우.
- 1b - NeptCore 모듈이 설치된 경우.

## 내부 M.2 드라이브 백플레인

이 섹션에서는 내부 M.2 드라이브의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

## M.2 드라이브 백플레인의 케이블 배선

백플레인 및 프로세서 보드의 M.2 커넥터 위치에 대한 자세한 내용은 *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 설명서*의 "내부 M.2 백플레인 및 M.2 드라이브 교체" 및 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 보드 어셈블리 커넥터"를 참조하십시오.

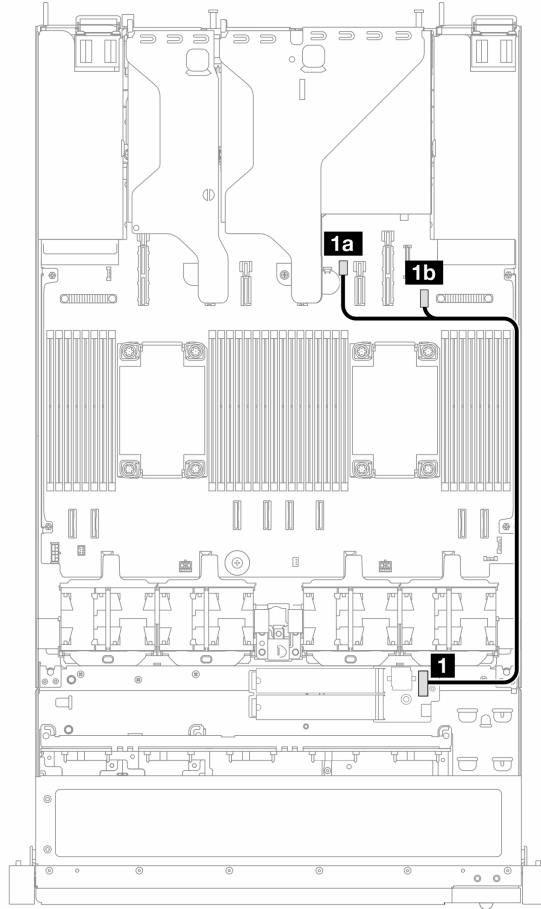


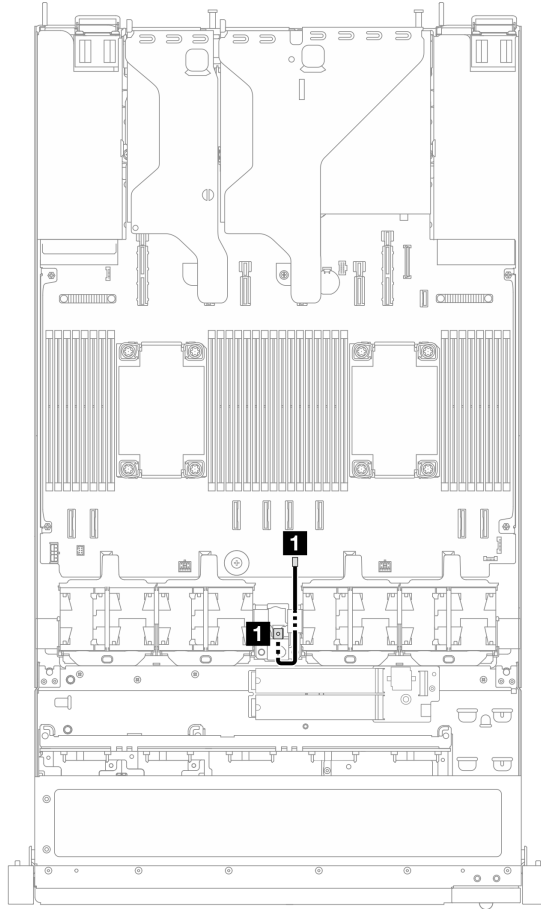
그림 7. 내부 M.2 백플레인의 케이블 배선

시작	끝
<b>1</b> 내부 M.2 백플레인	<b>1a</b> M.2 전원 커넥터
	<b>1b</b> M.2/7mm 백플레인 신호 커넥터

## 침입 스위치

이 섹션을 사용하여 침입 스위치에 대한 케이블 배선을 이해하십시오.

프로세서 보드의 침입 스위치 커넥터 위치의 경우 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 보드 어셈블리 커넥터"에서 자세한 내용을 참조하십시오.



**그림 8. 침입 스위치 케이블 배선**

시작	끝
<b>1</b> 침입 스위치 케이블	<b>1</b> 침입 스위치 커넥터

## OCP 인터포저 카드

이 섹션에서 OCP 인터포저 카드 2개와 프로세서 보드 간 케이블 배선을 알아보십시오.

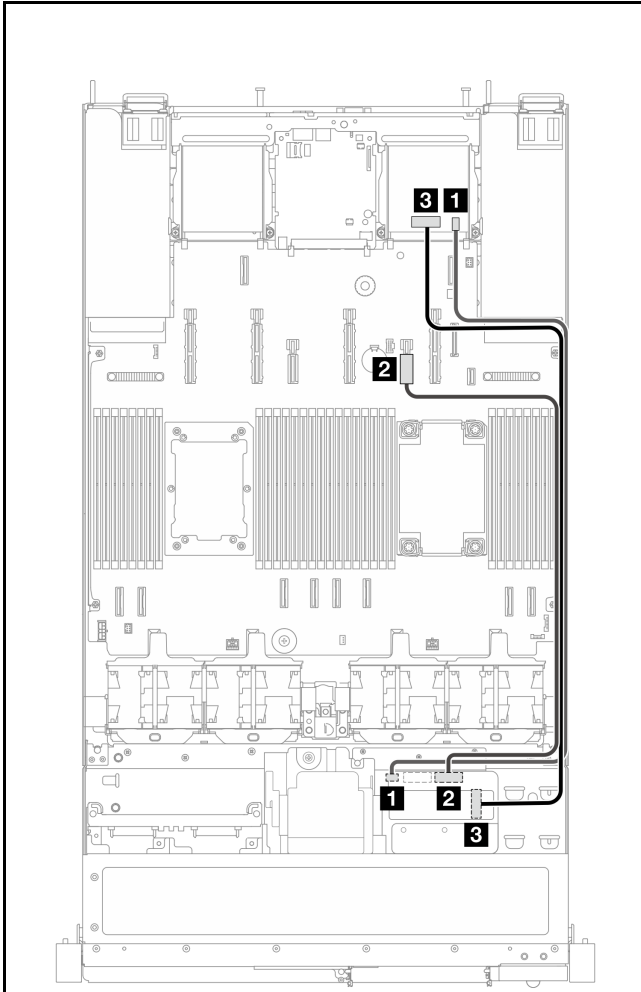


그림 9. x8 OCP 인터포저 카드의 케이블 배선

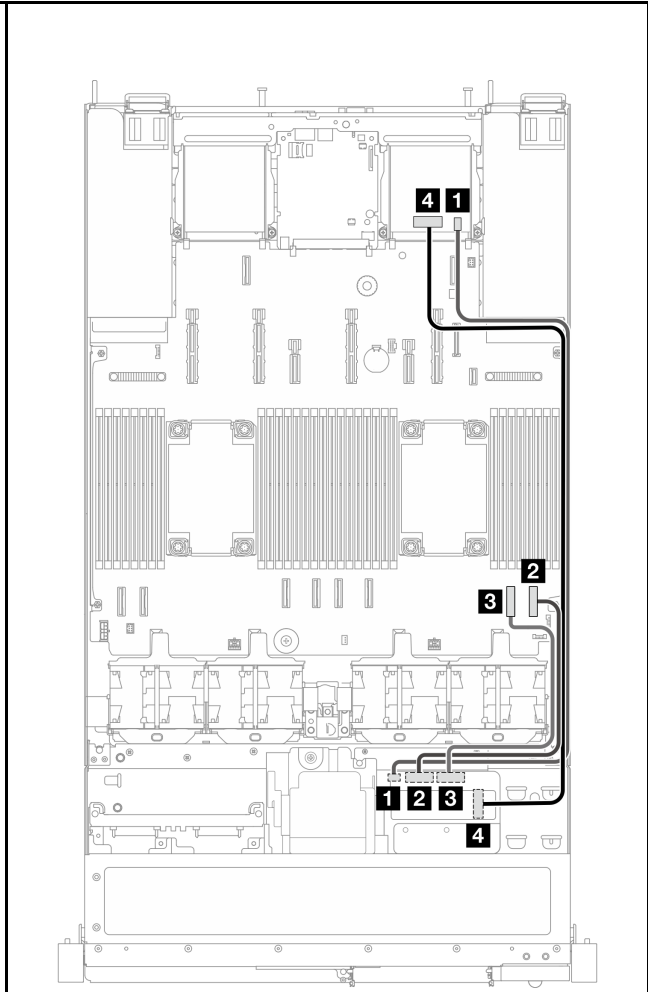


그림 10. x16 OCP 인터포저 카드의 케이블 배선

시작	끝	시작	끝
<b>1</b> 앞면 OCP 인터포저 전원	<b>1</b> 뒷면 OCP 인터포저 전원	<b>1</b> 앞면 OCP 인터포저 전원	<b>1</b> 뒷면 OCP 인터포저 전원
<b>2</b> OCP 인터포저 신호 (MCIO 1)	<b>2</b> 전원 및 PCIe 커넥터 10	<b>2</b> OCP 인터포저 신호 (MCIO 2)	<b>2</b> PCIe 커넥터 1
<b>3</b> 앞면 OCP 인터포저 전원 사이드밴드 (SWIFT)	<b>3</b> 뒷면 OCP 인터포저 전원 사이드밴드 (SWIFT)	<b>3</b> OCP 인터포저 신호 (MCIO 1)	<b>3</b> PCIe 커넥터 2
		<b>4</b> 앞면 OCP 인터포저 전원 사이드밴드 (SWIFT)	<b>4</b> 뒷면 OCP 인터포저 전원 사이드밴드 (SWIFT)

## OCP 모듈

이 섹션에서 OCP 모듈 2개의 케이블 배선을 알아보십시오.

프로세서 보드의 OCP 모듈 커넥터 위치에 대한 자세한 내용은 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 보드 어셈블리 커넥터"를 참조하십시오.



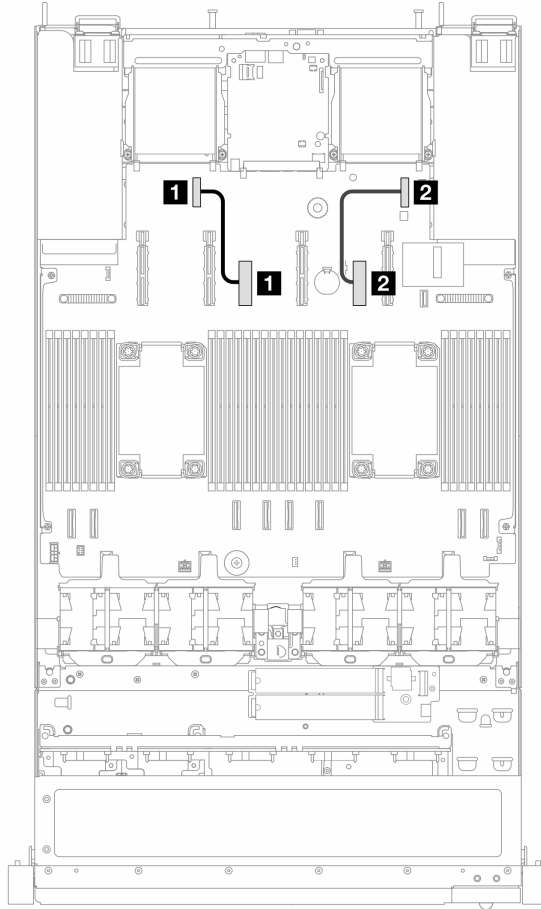


그림 11. OCP 모듈의 케이블 배선

시작	끝
<b>1</b> OCP 확장 커넥터 2	<b>1</b> 전원 및 PCIe 커넥터 12
<b>2</b> OCP 확장 커넥터 1	<b>2</b> 전원 및 PCIe 커넥터 10

## Processor Neptune™ Air Module

이 섹션을 사용하여 Processor Neptune™ Air Module (NeptAir)의 케이블 배선에 대해 알아보십시오.

- 프로세서 보드의 NeptAir 모듈 커넥터 위치에 대한 자세한 내용은 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 보드 어셈블리 커넥터"를 참조하십시오.
- 펌프 케이블 2개와 누수 감지 센서 모듈용 케이블 1개가 NeptAir 모듈에 통합되어 있으므로 케이블 3개가 모두 연결되어 있는지 확인하십시오.

**참고:** 케이블을 잘 정리하기 위해서 누수 감지 센서 모듈을 지정된 홀더에 장착해야 하며 모듈이 홀더 클립에 고정되었는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 아래 그림이나 *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 설명서*의 "Processor Neptune™ Air Module 설치"를 참조하십시오.

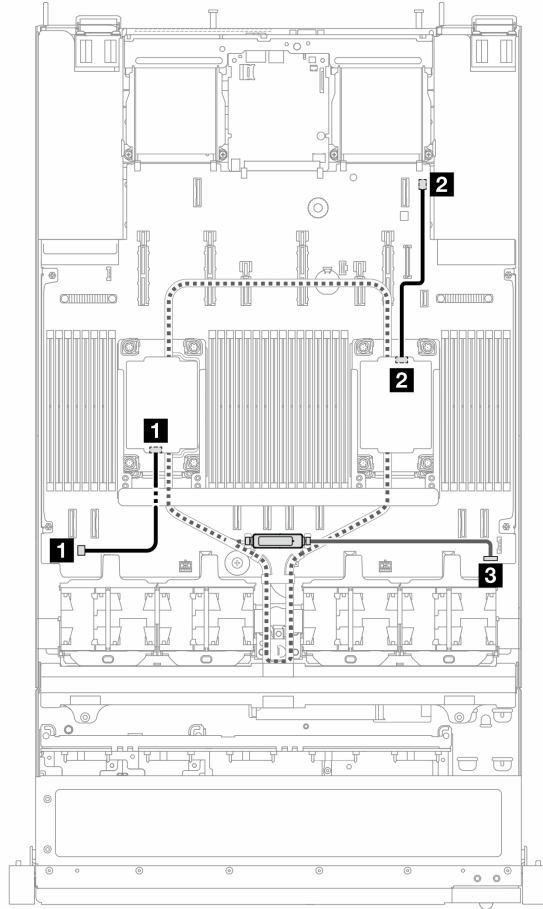


그림 12. NeptAir 모듈 케이블 배선

시작	끝
<b>1</b> 펌프 1	<b>1</b> 펌프 1 커넥터
<b>2</b> 펌프 2	<b>2</b> 펌프 2 커넥터
<b>3</b> 누수 감지 케이블	<b>3</b> 뒷면 누수 감지 커넥터

## Processor Neptune™ Core Module

이 섹션을 사용하여 Processor Neptune™ Core Module (NeptCore)의 케이블 배선에 대해 알아보십시오.

프로세서 보드의 누수 감지 센서 모듈 커넥터 위치의 경우 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 보드 어셈블리 커넥터"에서 자세한 내용을 참조하십시오.

참고: 케이블을 잘 정리하기 위해서 호스와 누수 감지 센서 모듈을 지정된 홀더에 장착해야 하며 모듈이 홀더 클립에 고정되었는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 아래 그림이나 *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 설명서*의 "Processor Neptune™ Core Module 설치"를 참조하십시오.

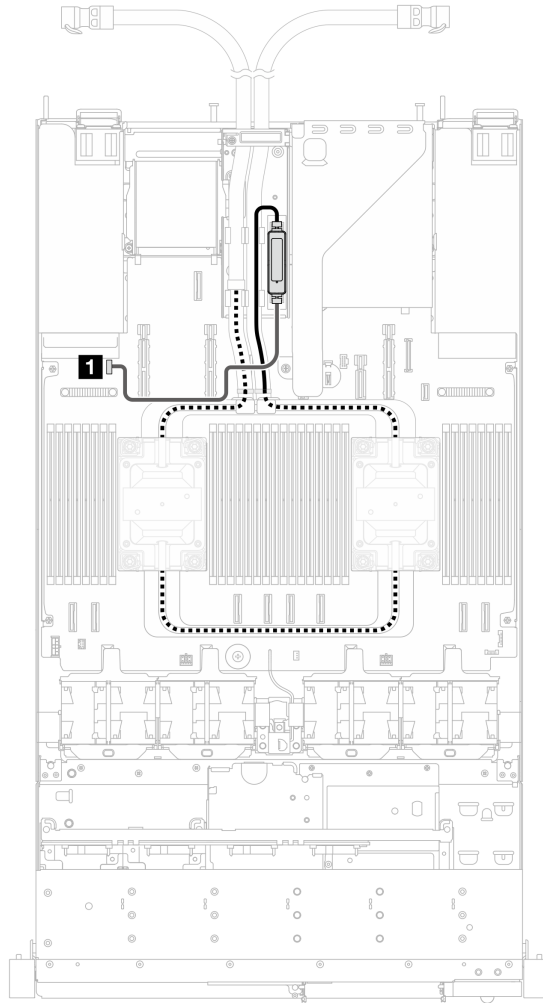


그림 13. NeptCore 모듈 케이블 배선

시작	끝
<b>1</b> 누수 감지 케이블	<b>1</b> 앞면 누수 감지 커넥터

## 뒷면 케이블 장착 라이저 카드

이 섹션에서 뒷면 케이블 장착 라이저 카드의 케이블 배선을 알아보십시오.

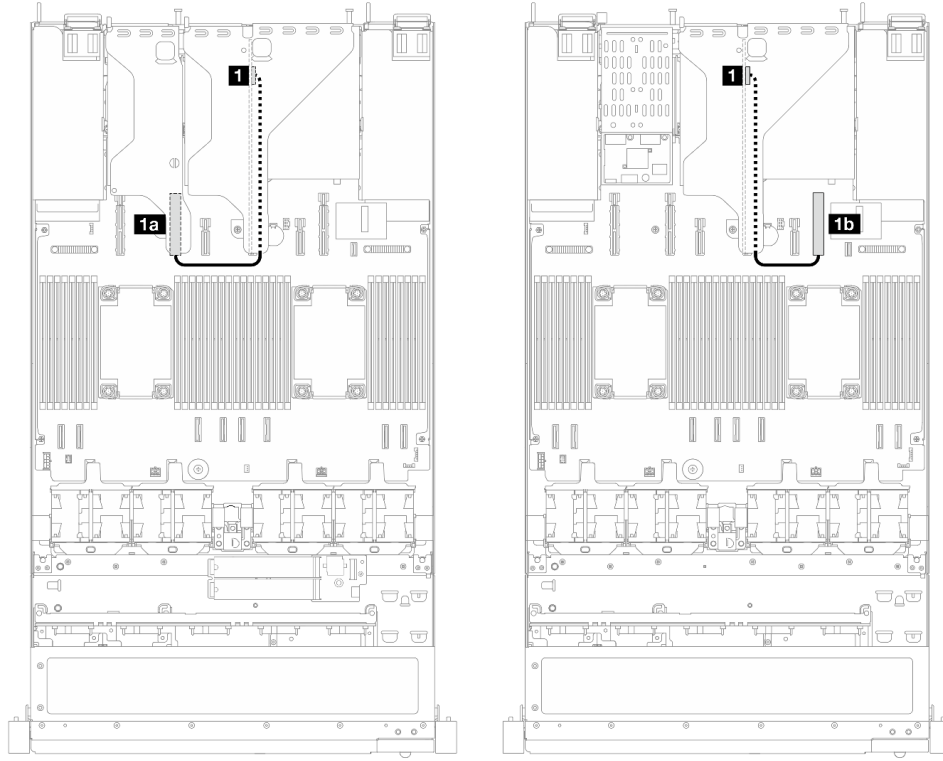


그림 14. 뒷면 케이블 장착 라이저 카드의 케이블 배선

시작	끝
1 뒷면 케이블 장착 라이저 카드	1a 전원 및 PCIe 커넥터 13
	1b 전원 및 PCIe 커넥터 9

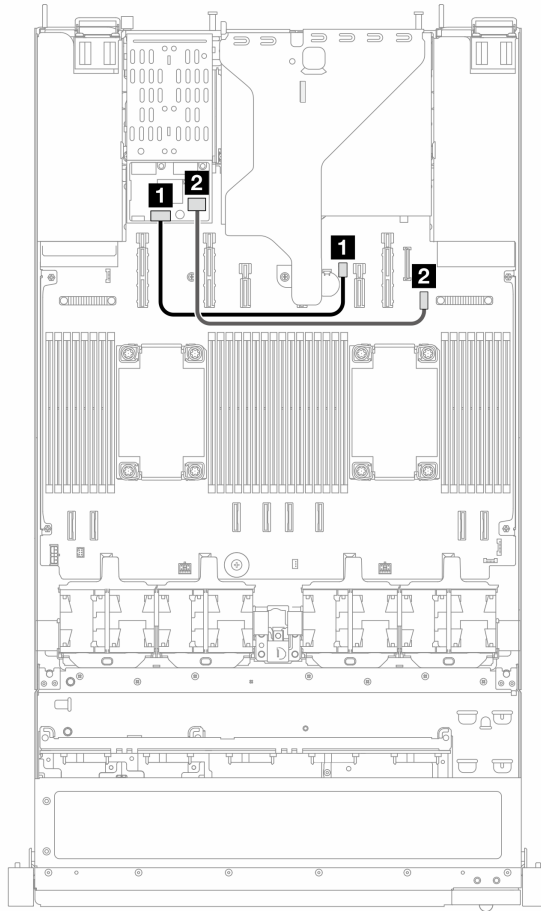
참고: 뒷면 케이블 장착 라이저의 케이블 배선은 구성에 따라 다릅니다.

- 시스템에 2개의 프로세서 및 뒷면 M.2 드라이브 어셈블리가 설치된 경우 **1a** 전원 및 PCIe 커넥터 13에 케이블을 연결합니다.
- 시스템에 3개의 PCIe 어댑터가 설치되어 있거나 프로세서 1개 구성인 경우, **1b** 전원 및 PCIe 커넥터 9에 케이블을 연결합니다.

## 뒷면 M.2 드라이브 백플레인

이 섹션에서는 뒷면 M.2 드라이브 백플레인의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

프로세서 보드의 뒷면 M.2 드라이브 백플레인 커넥터 위치에 대한 자세한 내용은 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 보드 어셈블리 커넥터"를 참조하십시오.



**그림 15. 뒷면 M.2 백플레인의 케이블 배선**

시작	끝
<b>1</b> 뒷면 M.2 드라이브 전원	<b>1</b> M.2 전원 커넥터
<b>2</b> 뒷면 M.2 드라이브 신호	<b>2</b> M.2/7mm 백플레인 신호 커넥터

## 직렬 포트 모듈

이 섹션에서는 직렬 포트 모듈의 케이블 배선 정보를 제공합니다.

시스템 I/O 보드의 직렬 포트 모듈 커넥터 위치의 경우 *사용 설명서* 또는 *시스템 구성 설명서*의 "시스템 보드 어셈블리 커넥터"에서 자세한 내용을 참조하십시오.

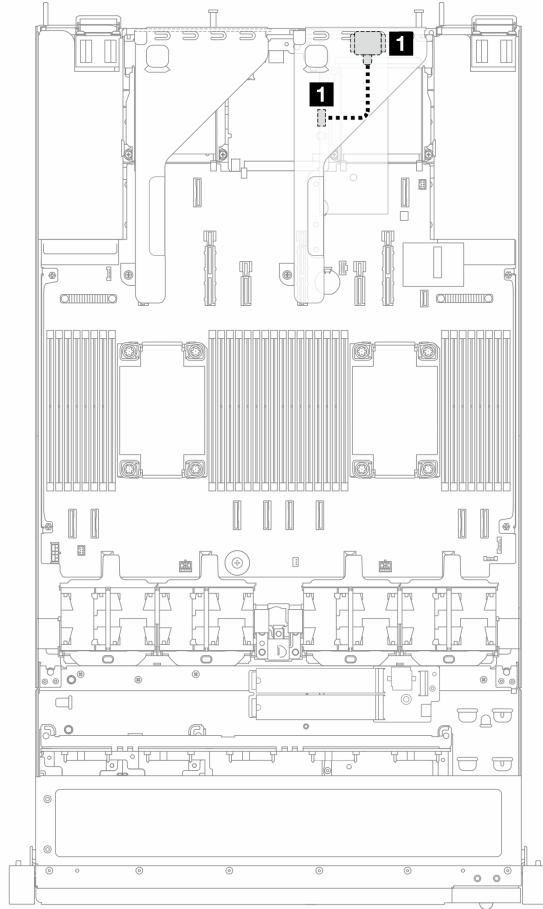


그림 16. 직렬 포트 모듈의 케이블 배선

시작	끝
<b>1</b> 직렬 포트 모듈	<b>1</b> 직렬 포트 커넥터

## 백플레인의 케이블 배선

이 섹션에서 다양한 구성의 백플레인의 케이블 배선을 찾을 수 있습니다.

### 4 x 2.5" 앞면 드라이브

이 섹션을 사용하여 4 x 2.5" 드라이브 백플레인의 신호 케이블 연결을 위한 케이블 배선을 알아보십시오.

- "4 x 2.5" NVMe 백플레인" 14페이지
- "4 x 2.5" NVMe 백플레인(프로세서 1개)" 15페이지
- "4 x 2.5" NVMe 백플레인(액체 냉각)" 16페이지
- "4 x 2.5" 앞면 드라이브(앞면 어댑터 어셈블리 포함)" 17페이지

### 4 x 2.5" NVMe 백플레인

이 섹션을 사용하여 4개의 2.5" 앞면 드라이브 및 2개의 프로세서가 장착된 서버 모델의 NVMe 백플레인 케이블 배선을 알아보십시오.

다음 표는 온보드 구성을 위한 백플레인 커넥터와 프로세서 보드 커넥터 간의 매핑 관계를 보여줍니다.

다음 그림은 4 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브 베이의 온보드 구성을 위한 케이블 배선을 보여줍니다. 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

### 온보드 구성의 케이블 배선

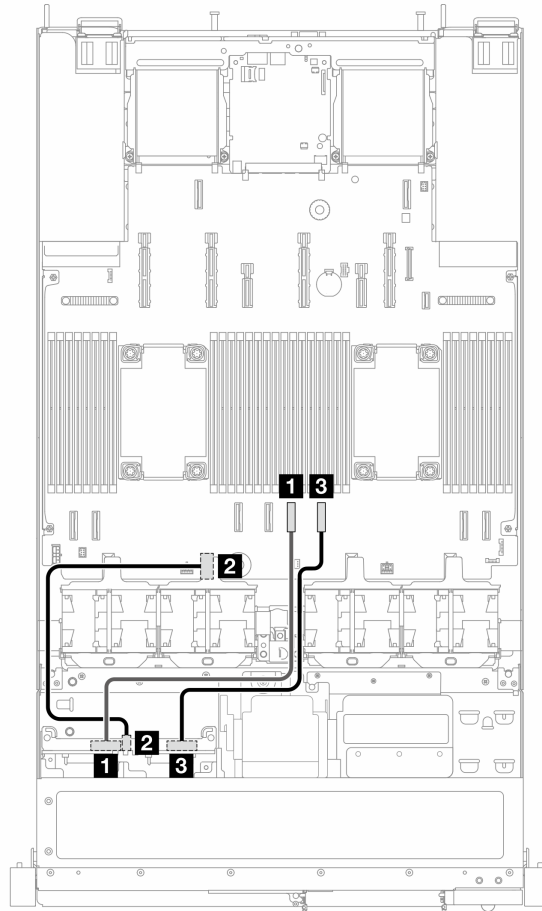


그림 17. 4 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브의 온보드 구성을 위한 케이블 배선

표 1. 온보드 구성을 위한 백플레인 및 프로세서 보드 간의 매핑

시작	끝
<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 4
<b>2</b> 전원	<b>2</b> 전원 커넥터 2_A
<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 3

### 4 x 2.5" NVMe 백플레인(프로세서 1개)

이 섹션을 사용하여 4개의 2.5" 앞면 드라이브 및 1개의 프로세서가 장착된 서버 모델의 NVMe 백플레인 케이블 배선을 알아보십시오.

다음 표는 온보드 구성을 위한 백플레인 커넥터와 프로세서 보드 커넥터 간의 매핑 관계를 보여줍니다.

다음 그림은 4 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브 베이의 온보드 구성을 위한 케이블 배선을 보여줍니다. 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

### 온보드 구성의 케이블 배선

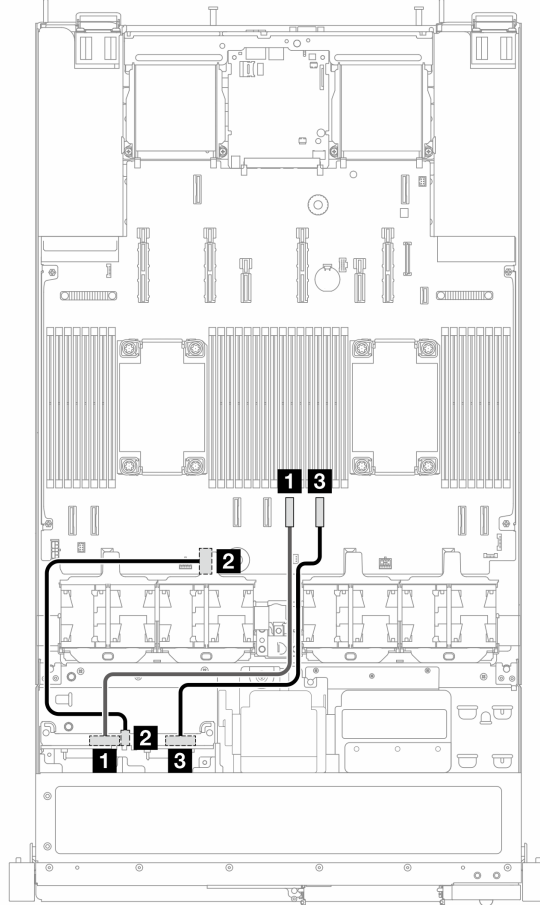


그림 18. 4 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브의 온보드 구성을 위한 케이블 배선

표 2. 온보드 구성을 위한 백플레인 및 프로세서 보드 간의 매핑

시작	끝
<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 4
<b>2</b> 전원	<b>2</b> 전원 커넥터 2_A
<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 3

### 4 x 2.5" NVMe 백플레인(액체 냉각)

이 섹션을 사용하여 액체 냉각(NeptAir 모듈) 구성을 위한 2.5" NVMe 드라이브 4개의 케이블 배선을 알아보십시오.

#### 액체 냉각(NeptAir 모듈)을 위한 NVMe 드라이브 4개의 온보드 케이블 연결

다음 표는 온보드 구성을 위한 백플레인 커넥터와 프로세서 보드 커넥터 간의 매핑 관계를 보여줍니다.



다음 그림은 4 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브 베이의 온보드 구성을 위한 케이블 배선을 보여줍니다. 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

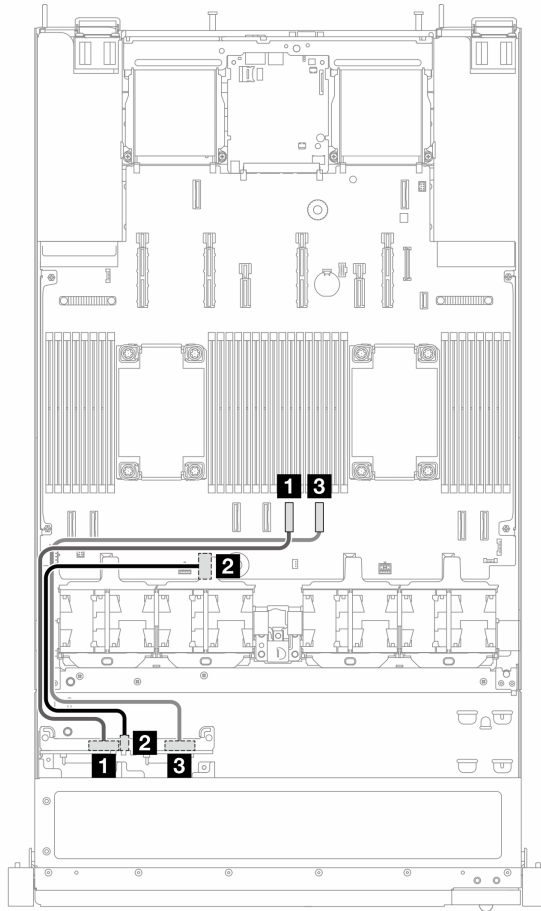


그림 19. 액체 냉각(NeptAir 모듈)을 위한 NVMe 드라이브 4개의 온보드 케이블 연결

표 3. 온보드 구성을 위한 백플레인 및 프로세서 보드 간의 매핑

시작	끝
<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 4
<b>2</b> 전원	<b>2</b> 전원 커넥터 2_A
<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 3

#### 4 x 2.5" 앞면 드라이브(앞면 어댑터 어셈블리 포함)

이 섹션을 사용하여 앞면 어댑터 어셈블리가 있는 4 x 2.5" 앞면 드라이브의 신호 케이블 연결을 위한 케이블 배선을 알아보십시오.

#### 4 x 2.5" NVMe 백플레인

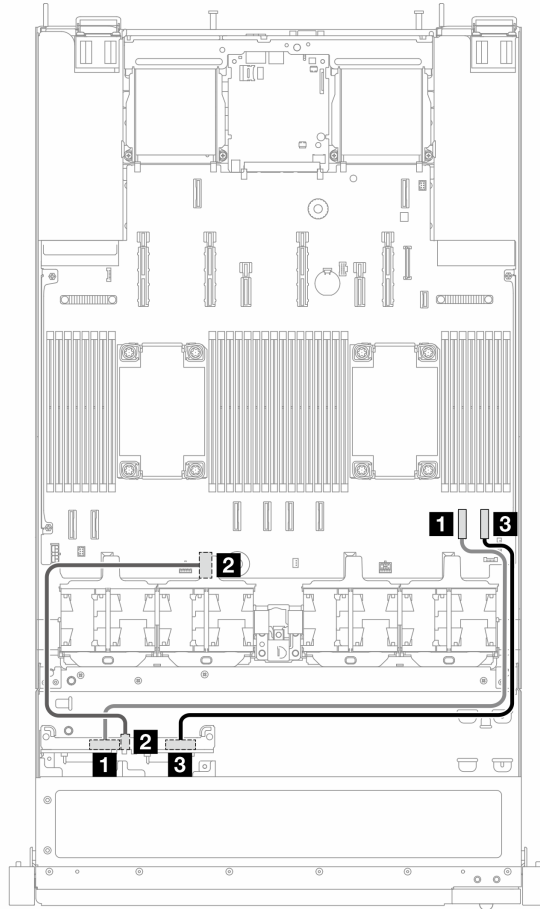
이 섹션을 사용하여 4개의 2.5" 앞면 드라이브 및 1개 또는 2개의 프로세서가 장착된 서버 모델의 NVMe 백플레인 케이블 배선을 알아보십시오.

앞면 어댑터 어셈블리의 케이블을 연결하려면 "앞면 어댑터 어셈블리" 4페이지의 내용을 참조하십시오.

다음 표는 온보드 구성을 위한 백플레인 커넥터와 프로세서 보드 커넥터 간의 매핑 관계를 보여줍니다.

다음 그림은 4 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브 베이의 온보드 구성을 위한 케이블 배선을 보여줍니다. 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

**프로세서가 1개인 온보드 구성을 위한 케이블 배선**



**그림 20. 4 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브의 온보드 구성을 위한 케이블 배선**

**표 4. 온보드 구성을 위한 백플레인 및 프로세서 보드 간의 매핑**

시작	끝
<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 2
<b>2</b> 전원	<b>2</b> 전원 커넥터 2_A
<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 1

## 프로세서가 2개인 온보드 구성을 위한 케이블 배선

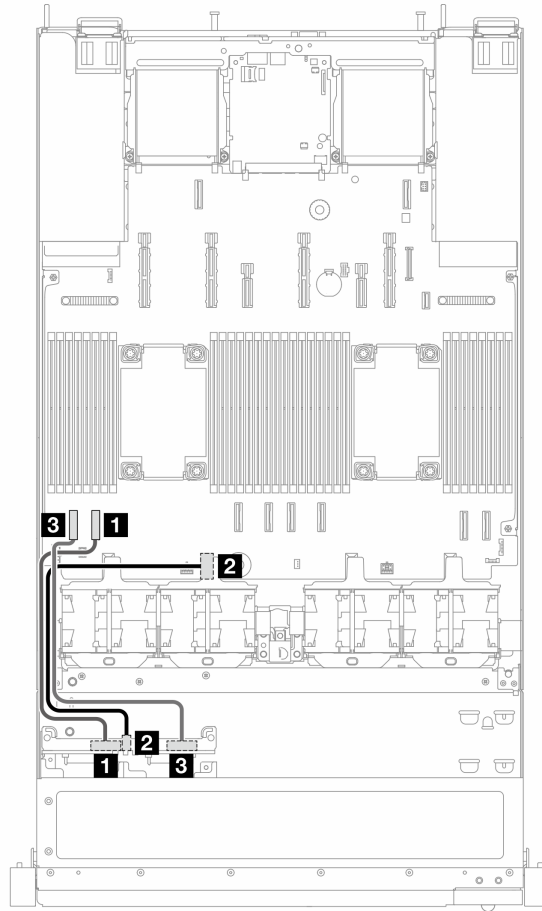


그림 21. 4 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브의 온보드 구성을 위한 케이블 배선

표 5. 온보드 구성을 위한 백플레인 및 프로세서 보드 간의 매핑

시작	끝
<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 7
<b>2</b> 전원	<b>2</b> 전원 커넥터 2_A
<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 8

## 8 x 2.5" 앞면 드라이브

이 섹션을 사용하여 8 x 2.5" 드라이브 백플레인의 신호 케이블 연결을 위한 케이블 배선을 알아보십시오.

- "8 x 2.5" NVMe 드라이브(4 x 2.5" NVMe 백플레인 2개 포함)" 20페이지
- "8 x 2.5" NVMe 드라이브(4 x 2.5" NVMe 백플레인 2개 포함)(프로세서 1개)" 21페이지
- "8 x 2.5" NVMe 드라이브(4 x 2.5" NVMe 백플레인 2개 포함)(액체 냉각)" 22페이지
- "8 x 2.5" NVMe 드라이브(4 x 2.5" NVMe 백플레인 2개 포함)(프로세서 1개 및 액체 냉각)" 23페이지

## 8 x 2.5" NVMe 드라이브(4 x 2.5" NVMe 백플레인 2개 포함)

이 섹션에서 4 x 2.5" NVMe 백플레인 2개 및 프로세서 2개가 설치된 NVMe 드라이브 8개의 케이블 배선을 알아보십시오.

### 온보드 구성의 케이블 배선

다음 표는 온보드 구성을 위한 백플레인 커넥터와 프로세서 보드 커넥터 간의 매핑 관계를 보여줍니다.

다음 그림은 8 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브 베이의 온보드 구성을 위한 케이블 배선을 보여줍니다. 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

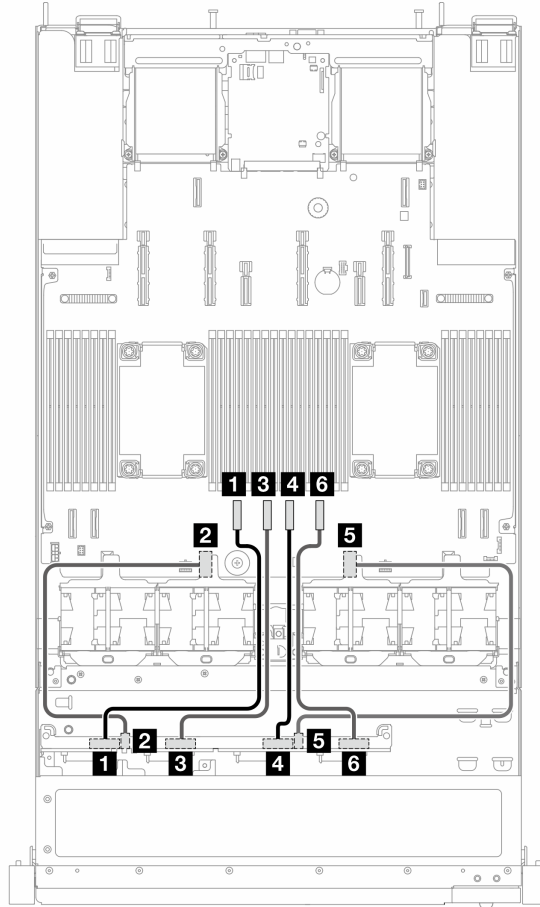


그림 22. 8 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브의 온보드 구성을 위한 케이블 배선

표 6. 온보드 구성을 위한 백플레인 및 프로세서 보드 간의 매핑

백플레인	시작: 백플레인	케이블 실크스크린	끝
4 x 2.5" NVMe 백플레인 1	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 6
	<b>2</b> 전원	<b>2</b> 전원	<b>2</b> 전원 커넥터 2_A
	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 5
4 x 2.5" NVMe 백플레인 2	<b>4</b> NVMe 0-1	<b>4</b> NVMe 4-5	<b>4</b> PCIe 4
	<b>5</b> 전원	<b>5</b> 전원	<b>5</b> 전원 커넥터 3_A
	<b>6</b> NVMe 2-3	<b>6</b> NVMe 6-7	<b>6</b> PCIe 3

## 8 x 2.5" NVMe 드라이브(4 x 2.5" NVMe 백플레인 2개 포함)(프로세서 1개)

이 섹션에서 4 x 2.5" NVMe 백플레인 2개 및 프로세서 1개가 설치된 NVMe 드라이브 8개의 케이블 배선을 알아보십시오.

### 온보드 구성의 케이블 배선

다음 그림과 표는 온보드 구성을 위한 백플레인 커넥터와 프로세서 보드 커넥터 간의 매핑 관계를 보여줍니다.

다음 그림은 8 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브 베이의 온보드 구성을 위한 케이블 배선을 보여줍니다. 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.

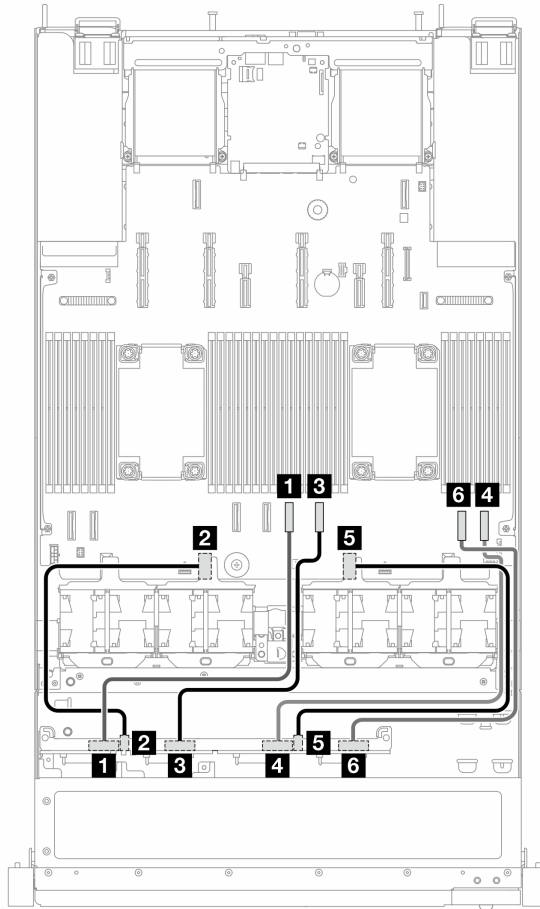


그림 23. 8 x 2.5" NVMe 앞면 드라이브의 온보드 구성을 위한 케이블 배선

표 7. 온보드 구성을 위한 백플레인 및 프로세서 보드 간의 매핑

백플레인	시작: 백플레인	케이블 실크스크린	끝
4 x 2.5" NVMe 백플레인 1	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 4
	<b>2</b> 전원	<b>2</b> 전원	<b>2</b> 전원 커넥터 2_A
	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 3
4 x 2.5" NVMe 백플레인 2	<b>4</b> NVMe 0-1	<b>4</b> NVMe 4-5	<b>4</b> PCIe 1
	<b>5</b> 전원	<b>5</b> 전원	<b>5</b> 전원 커넥터 3_A
	<b>6</b> NVMe 2-3	<b>6</b> NVMe 6-7	<b>6</b> PCIe 2

## 8 x 2.5" NVMe 드라이브(4 x 2.5" NVMe 백플레인 2개 포함)(액체 냉각)

이 섹션에서 4 x 2.5" NVMe 백플레인 2개가 설치된 액체 냉각(NeptAir 모듈) 구성을 위한 NVMe 앞면 드라이브 8개의 케이블 배선을 알아보십시오.

### 온보드 구성의 케이블 배선

다음 표는 온보드 구성을 위한 백플레인 커넥터와 프로세서 보드 커넥터 간의 매핑 관계를 보여줍니다.

다음 그림은 8 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브 베이의 온보드 구성을 위한 케이블 배선을 보여줍니다. 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

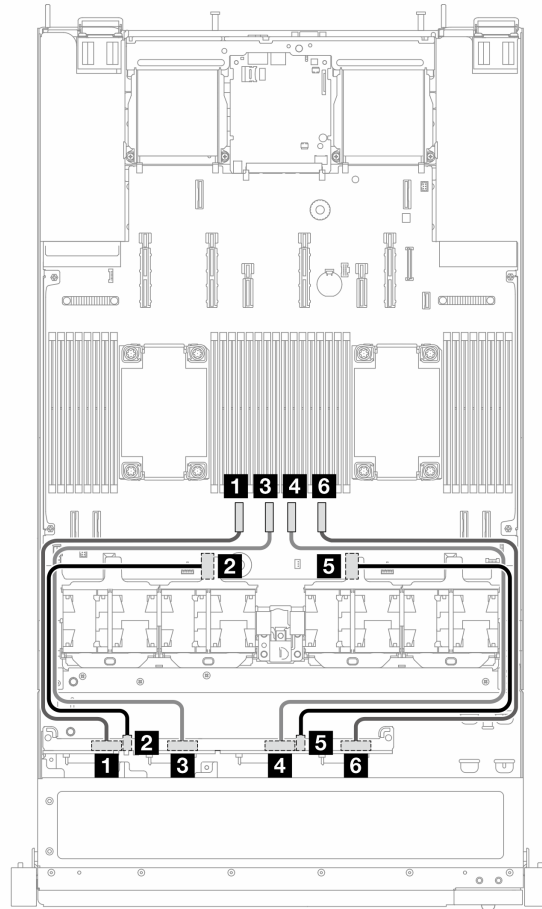


그림 24. 8 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브의 온보드 구성을 위한 케이블 배선

표 8. 온보드 구성을 위한 백플레인 및 프로세서 보드 간의 매핑

백플레인	시작: 백플레인	케이블 실크스크린	끝
4 x 2.5" NVMe 백플레인 1	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 6
	<b>2</b> 전원	<b>2</b> 전원	<b>2</b> 전원 커넥터 2_A
	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 5
4 x 2.5" NVMe 백플레인 2	<b>4</b> NVMe 0-1	<b>4</b> NVMe 4-5	<b>4</b> PCIe 4
	<b>5</b> 전원	<b>5</b> 전원	<b>5</b> 전원 커넥터 3_A
	<b>6</b> NVMe 2-3	<b>6</b> NVMe 6-7	<b>6</b> PCIe 3

## 8 x 2.5" NVMe 드라이브(4 x 2.5" NVMe 백플레인 2개 포함)(프로세서 1개 및 액체 냉각)

이 섹션에서 4 x 2.5" NVMe 백플레인 2개 및 프로세서 1개가 설치된 액체 냉각(NeptAir 모듈) 구성을 위한 NVMe 드라이브 8개의 케이블 배선을 알아보십시오.

### 온보드 구성의 케이블 배선

다음 표는 온보드 구성을 위한 백플레인 커넥터와 프로세서 보드 커넥터 간의 매핑 관계를 보여줍니다.

다음 그림은 8 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브 베이의 온보드 구성을 위한 케이블 배선을 보여줍니다. 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

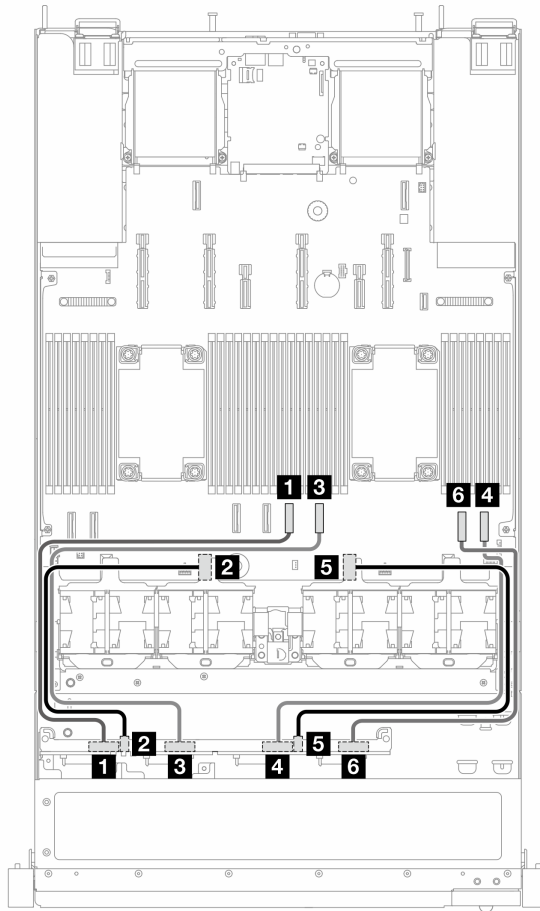


그림 25. 8 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브의 온보드 구성을 위한 케이블 배선

표 9. 온보드 구성을 위한 백플레인 및 프로세서 보드 간의 매핑

백플레인	시작: 백플레인	케이블 실크스크린	끝
4 x 2.5" NVMe 백플레인 1	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 4
	<b>2</b> 전원	<b>2</b> 전원	<b>2</b> 전원 커넥터 2_A
	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> NVMe 2-3	<b>3</b> PCIe 3

**표 9. 온보드 구성을 위한 백플레인 및 프로세서 보드 간의 매핑 (계속)**

백플레인	시작: 백플레인	케이블 실크스크린	끝
4 x 2.5" NVMe 백플레인 2	<b>4</b> NVMe 0-1	<b>4</b> NVMe 4-5	<b>4</b> PCIe 1
	<b>5</b> 전원	<b>5</b> 전원	<b>5</b> 전원 커넥터 3_A
	<b>6</b> NVMe 2-3	<b>6</b> NVMe 6-7	<b>6</b> PCIe 2

## 10 x 2.5" 앞면 드라이브

이 섹션을 사용하여 10 x 2.5" 드라이브 백플레인의 신호 케이블 연결을 위한 케이블 배선을 알아보십시오.

- "10 x 2.5" NVMe" 24페이지
- "10 x 2.5" NVMe(액체 냉각)" 25페이지
- "12 x 2.5" NVMe" 26페이지

## 10 x 2.5" NVMe

이 섹션을 참조하여 10 x 2.5" AnyBay 백플레인이 설치된 앞면 NVMe 드라이브 10개의 케이블 배선을 알아보십시오.

### 온보드 구성의 케이블 배선

다음 표는 온보드 구성을 위한 백플레인 커넥터와 시스템 보드 커넥터 간의 매핑 관계를 보여줍니다.

다음 그림은 10 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브 베이의 온보드 구성을 위한 케이블 배선을 보여줍니다. 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**



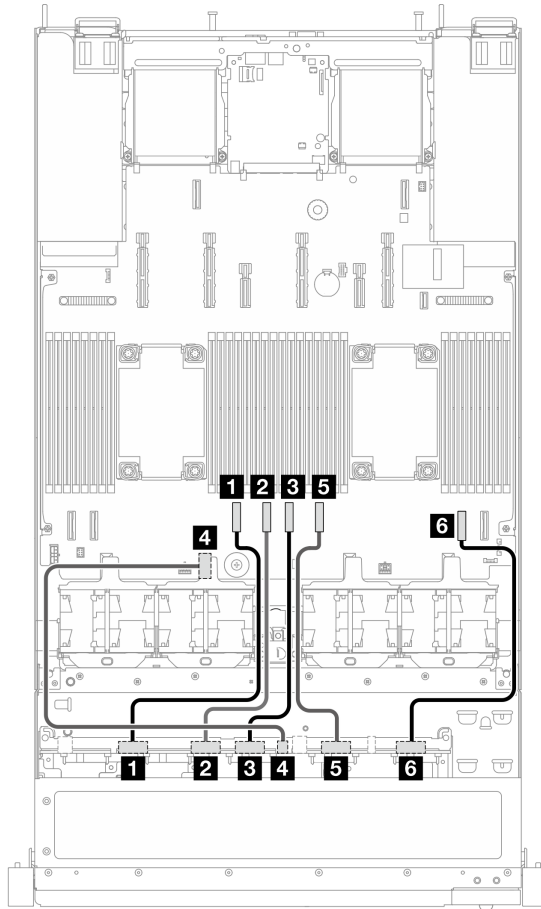


그림 26. 10 x 2.5" NVMe 앞면 드라이브의 온보드 구성을 위한 케이블 배선

표 10. 온보드 구성을 위한 1개의 앞면 AnyBay 백플레인과 프로세서 보드 간의 매핑

시작	끝
<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 6
<b>2</b> NVMe 2-3	<b>2</b> PCIe 5
<b>3</b> NVMe 4-5	<b>3</b> PCIe 4
<b>4</b> 전원	<b>4</b> 전원 커넥터 2_A
<b>5</b> NVMe 6-7	<b>5</b> PCIe 3
<b>6</b> NVMe 8-9	<b>6</b> PCIe 2

### 10 x 2.5" NVMe(액체 냉각)

이 섹션을 사용하여 10 x 2.5" AnyBay 앞면 백플레인이 설치된 액체 냉각(NeptAir 모듈) 구성을 위한 10개의 NVMe 앞면 드라이브 케이블 배선을 알아보십시오.

#### 액체 냉각(NeptAir 모듈)을 위한 10개의 NVMe 드라이브 온보드 케이블 연결

다음 표는 온보드 구성을 위한 백플레인 커넥터와 시스템 보드 커넥터 간의 매핑 관계를 보여줍니다.

다음 그림은 10 x 2.5" 앞면 NVMe 드라이브 베이의 온보드 구성을 위한 케이블 배선을 보여줍니다. 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

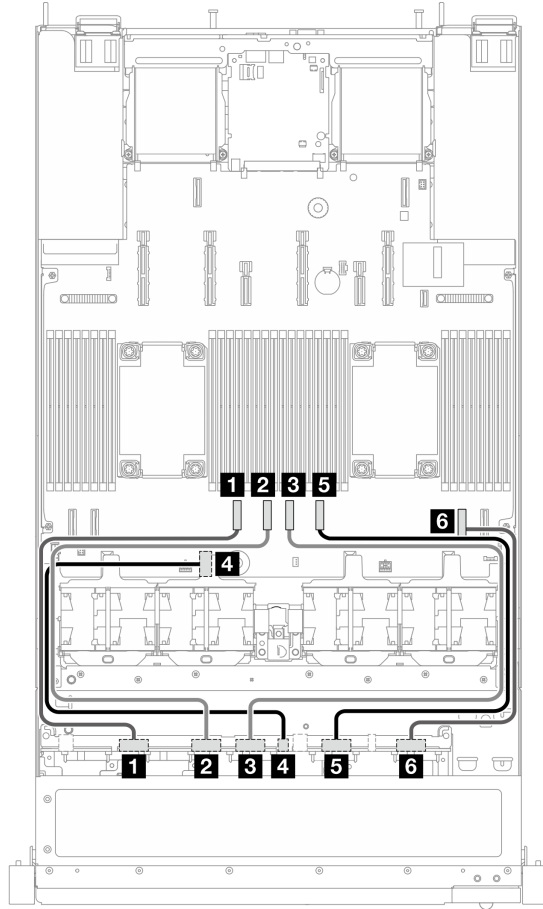


그림 27. 액체 냉각(NeptAir 모듈)을 위한 10개의 NVMe 드라이브 온보드 케이블 연결

표 11. 온보드 구성을 위한 1개의 전면 AnyBay 백플레인과 프로세서 보드 간의 매핑

시작	끝
<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 6
<b>2</b> NVMe 2-3	<b>2</b> PCIe 5
<b>3</b> NVMe 4-5	<b>3</b> PCIe 4
<b>4</b> 전원	<b>4</b> 전원 커넥터 2_A
<b>5</b> NVMe 6-7	<b>5</b> PCIe 3
<b>6</b> NVMe 8-9	<b>6</b> PCIe 2

## 12 x 2.5" NVMe

이 섹션을 참조하여 10 x 2.5" 백플레인이 설치된 전면 NVMe 드라이브 12개의 케이블 배선을 알아보십시오.

### 온보드 구성의 케이블 배선

다음 표는 온보드 구성을 위한 백플레인 커넥터와 시스템 보드 커넥터 간의 매핑 관계를 보여줍니다.

다음 그림은 12 x 2.5" 전면 NVMe 드라이브 베이의 온보드 구성을 위한 케이블 배선을 보여줍니다. 커넥터 간 연결: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

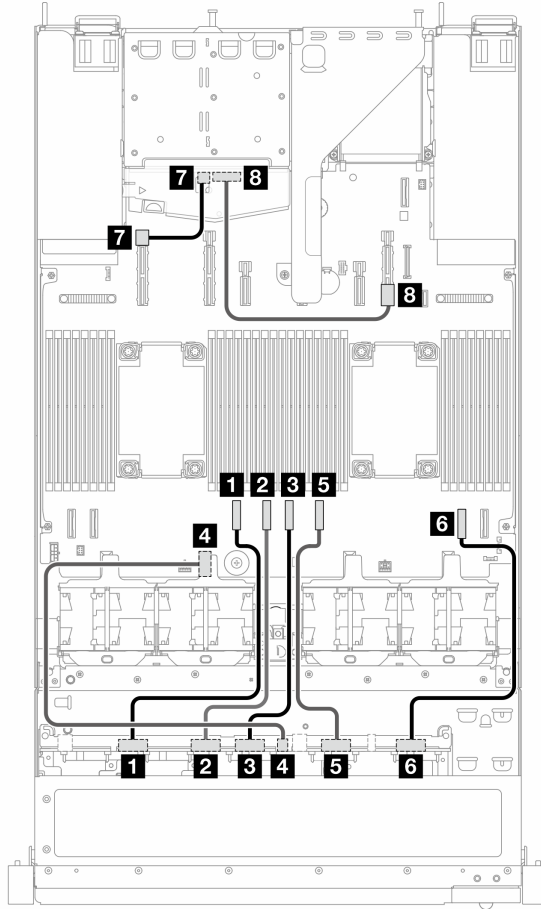


그림 28. 12 x 2.5" NVMe 앞면 드라이브의 온보드 구성을 위한 케이블 배선

표 12. 온보드 구성을 위한 1개의 앞면 AnyBay 백플레인과 프로세서 보드 간의 매핑

백플레인	시작	끝
앞면 백플레인	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> PCIe 6
	<b>2</b> NVMe 2-3	<b>2</b> PCIe 5
	<b>3</b> NVMe 4-5	<b>3</b> PCIe 4
	<b>4</b> 전원	<b>4</b> 전원 커넥터 2_A
	<b>5</b> NVMe 6-7	<b>5</b> PCIe 3
	<b>6</b> NVMe 8-9	<b>6</b> PCIe 2
뒷면 백플레인	<b>7</b> 전원	<b>7</b> 전원 및 PCIe 커넥터 15의 전원
	<b>8</b> NVMe	<b>8</b> 전원 및 PCIe 커넥터 9의 신호



---

## 부록 A. 문서 및 지원

이 섹션에서는 유용한 문서, 드라이버 및 펌웨어 다운로드, 지원 리소스를 제공합니다.

---

### 문서 다운로드

이 섹션에서는 소개 및 유용한 문서의 다운로드 링크를 제공합니다.

#### 문서

- **레일 설치 안내서**
  - 랙에 레일 설치
- **CMA 설치 안내서**
  - 랙에 케이블 관리 암(CMA) 설치
- **사용 설명서**
  - 전체 개요, 시스템 구성, 하드웨어 구성 요소 교체 및 문제 해결.  
사용 설명서의 일부 장:
    - **시스템 구성 설명서:** 서버 개요, 구성 요소 식별, 시스템 LED 및 진단 디스플레이, 제품 개봉, 서버 설정 및 구성.
    - **하드웨어 유지 관리 설명서:** 하드웨어 구성 요소 설치 및 문제 해결.
- **케이블 배선 가이드**
  - 케이블 배선 정보.
- **메시지 및 코드 참조서**
  - XClarity Controller, LXPM 및 uEFI 이벤트
- **UEFI 매뉴얼**
  - UEFI 설정 소개

---

### 지원 웹 사이트

이 섹션에서는 드라이버 및 펌웨어 다운로드와 지원 리소스를 제공합니다.



---

## 부록 B. 주의사항

Lenovo가 모든 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하는 것은 아닙니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

이 책에서 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스만 사용할 수 있다는 것은 아닙니다. Lenovo의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 기타 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가와 검증은 사용자의 책임입니다.

Lenovo는 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공하는 것은 오픈링이 아니며 이 책을 제공한다고 해서 특허 또는 특허 응용 프로그램에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

Lenovo는 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 이 책을 "현재 상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. Lenovo는 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 책에서 설명한 제품은 오작동으로 인해 인체 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 이식 또는 기타 생명 유지 응용 프로그램에서 사용하도록 고안되지 않았습니다. 이 책에 포함된 정보는 Lenovo 제품 사양 또는 보증에 영향을 미치거나 그 내용을 변경하지 않습니다. 이 책의 어떠한 내용도 Lenovo 또는 타사의 지적 재산권 하에서 묵시적 또는 명시적 라이선스 또는 면책 사유가 될 수 없습니다. 이 책에 포함된 모든 정보는 특정 환경에서 얻은 것이며 설명 목적으로만 제공됩니다. 운영 환경이 다르면 결과가 다를 수 있습니다.

Lenovo는 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

이 책에서 언급되는 Lenovo 이외 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 Lenovo 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

본 책에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 운영 환경이 다르면 결과가 현저히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

---

## 상표

LENOVO 및 THINKSYSTEM은 Lenovo의 상표입니다.

기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

---

## 중요 참고사항

프로세서 속도는 프로세서의 내부 클럭 속도를 나타냅니다. 다른 요소 또한 응용 프로그램 성능에 영향을 줍니다.

CD 또는 DVD 드라이브 속도는 읽기 속도가 가변적입니다. 실제 속도는 표시된 속도와는 다르며 일반적으로 가능한 최대값보다 작습니다.

프로세서 스토리지, 실제 및 가상 스토리지 또는 채널 볼륨을 언급할 때, KB는 1,024바이트, MB는 1,048,576바이트, GB는 1,073,741,824바이트를 나타냅니다.

하드 디스크 드라이브 용량 또는 통신 볼륨을 언급할 때 MB는 1,000,000바이트, GB는 1,000,000,000바이트를 나타냅니다. 사용자가 액세스할 수 있는 총량은 운영 환경에 따라 다를 수 있습니다.

최대 내장 하드 디스크 드라이브 용량은 모든 하드 디스크 드라이브 베이에서 표준 하드 디스크 드라이브를 현재 Lenovo에서 지원되는 가장 큰 드라이브로 교체한 상태에서의 용량을 나타냅니다.

최대 메모리를 사용하려면 표준 메모리를 옵션 메모리 모듈로 교체해야 할 수도 있습니다.

각 솔리드 스테이트 메모리 셀에는 셀에서 발생할 수 있는 고유한 한정된 수의 쓰기 주기가 들어 있습니다. 따라서 솔리드 스테이트 장치는 TBW(total bytes written)로 표시될 수 있는 최대 쓰기 주기 수를 갖습니다. 이 한도를 초과한 장치는 시스템에서 생성된 명령에 응답하지 못하거나 기록할 수 없을 수도 있습니다. Lenovo는 장치에 대한 공식 발행 사양에 설명된 대로 최대 프로그램 보장 횟수/삭제 주기를 초과한 장치의 교체에 대해 책임을 지지 않습니다.

Lenovo는 Lenovo 이외 제품에 대해서는 어떠한 진술 또는 보증도 하지 않습니다. Lenovo 이외 제품에 대한 지원은 Lenovo가 아닌 타사에서 제공됩니다.

일부 소프트웨어는 일반 정품 버전과 차이가 있을 수 있으며, 사용 설명서나 일부 프로그램 기능이 포함되지 않을 수도 있습니다.

---

## 전자 방출 주의사항

모니터를 장비에 연결할 경우 지정된 모니터 케이블과 모니터와 함께 제공되는 간섭 억제 장치를 사용해야 합니다.

추가 전자 방출 주의사항은 다음에서 제공됩니다.

[https://pubs.lenovo.com/important\\_notices/](https://pubs.lenovo.com/important_notices/)



## 대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組合作件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組合作件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組合作件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt%” 及 “超出0.01 wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 대만 지역 수입 및 수출 연락처 정보

대만 지역 수입 및 수출 정보를 문의할 수 있는 연락처가 제공됩니다.

**委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司**

**進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓**

**進口商電話: 0800-000-702**

## TCO 인증

선택한 모델/구성은 TCO 인증 요구 사항을 충족하고 TCO 인증 라벨을 부착합니다.

참고: TCO 인증은 IT 제품에 대한 국제적인 제3자 지속 가능성 인증입니다. 자세한 내용은 <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/tco/> 를 참조하세요.





Lenovo